

# 性 能 表




(1/2)

品名	8芯モジュージャック (リバーズSMTタイプ) RoHS指令対応品	社内番号	MOD-WRJ88LY(1,2)G+
適用・引用規格	IEC 準拠		
適合コネクタ	8芯モジュラープラグ		
定格	A.C.125V (r.m.s.) 0.5A		
使用温度範囲	-40°C ~ +70°C 相対湿度 90%以下		
保管温度範囲	+5°C ~ +40°C 相対湿度 10% ~ 75%		
最大保管期間	1年間		

## 特 性

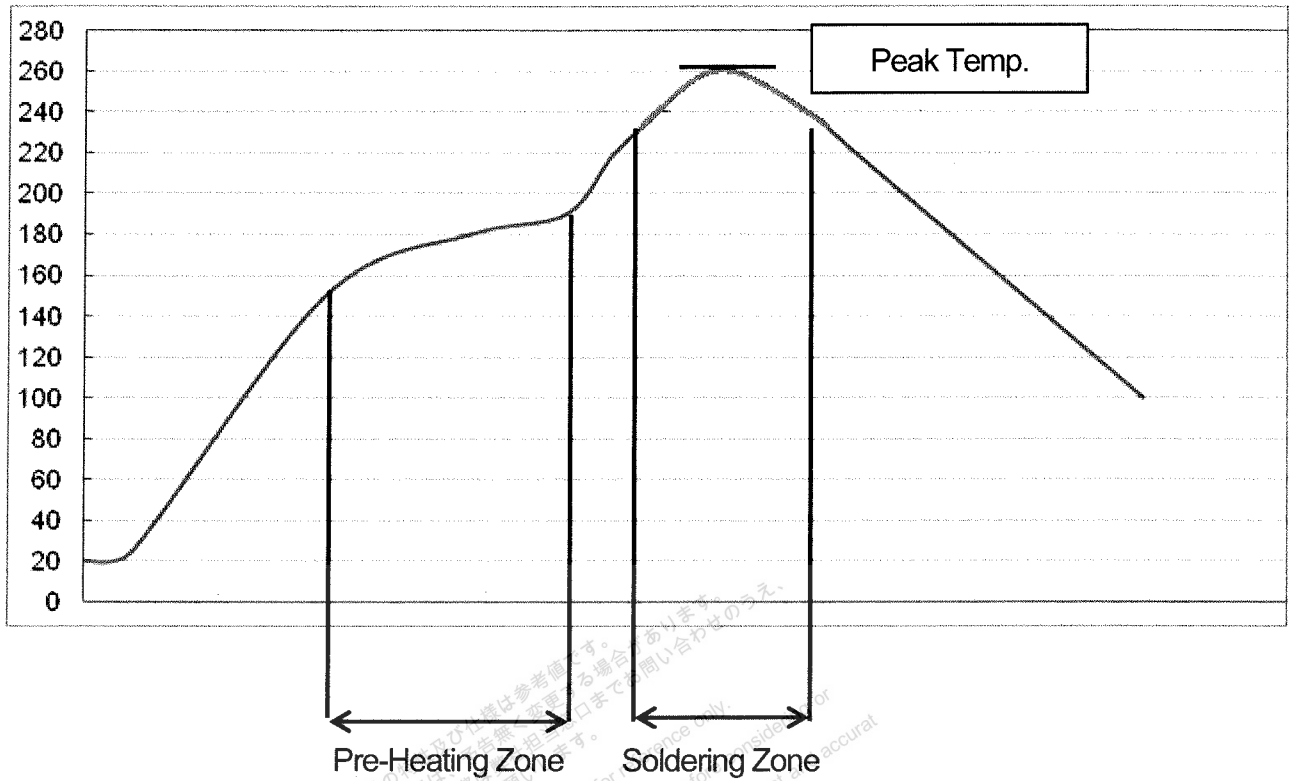
No.	項目	条 件	認定試験	製品検査
1	構造・形状・寸法	付図及び適用・引用規格に適合すること。	○	○
2	材料・仕上・表示	同上。	○	○
3	結合性	適合コネクタと異常無く結合すること。	○	○
4	耐電圧	A.C. 500V (r.m.s.) を1分間印加して絶縁破壊の無いこと。	○	○
5	絶縁抵抗	D.C. 100V で測定したとき 500MΩ以上のこと。	○	-
6	接触抵抗	100mΩ以下。	○	-
7	耐振性	周波数: 10Hz ~ 55Hz 振幅: 1.5mm 方向: X、Y、Z方向 試験時間: 各方向2H 試験中、1μs以上の瞬断が無いこと。 試験後、物理的な損傷が無いこと。接触抵抗: 100mΩ以下。	○	-
8	耐衝撃性	加速度: 490m/s <sup>2</sup> 試験方向: X、Y、Z方向各3回 合計9回 試験中、1μs以上の瞬断が無いこと。 試験後、物理的な損傷が無いこと。接触抵抗: 100mΩ以下。	○	-
9	耐湿性	温度: 40°C±2°C 湿度: 90% ~ 95% 時間: 96H 絶縁抵抗: 500MΩ以上。耐電圧: 絶縁破壊の無いこと。 接触抵抗: 100mΩ以下。	○	-
10	熱衝撃	温度: -40°C ~ +70°C 試験時間: 1サイクル1Hで5サイクル 割れ等の異常の無いこと。接触抵抗: 100mΩ以下。	○	-
11	耐寒性	温度: -40°C±3°C 試験時間: 96H 絶縁抵抗: 500MΩ以上。耐電圧: 絶縁破壊の無いこと。 割れ等の異常の無いこと。接触抵抗: 100mΩ以下。	○	-
12	耐熱性	温度: 70°C±2°C 試験時間: 96H 絶縁抵抗: 500MΩ以上。耐電圧: 絶縁破壊の無いこと。 割れ等の異常の無いこと。接触抵抗: 100mΩ以下。	○	-
13	温湿度サイクル	温度: 25°C ~ 65°C 湿度: 90% ~ 96% 試験時間: 1サイクル24Hで10サイクル 絶縁抵抗: 500MΩ以上。耐電圧: 絶縁破壊の無いこと。 割れ等の異常の無いこと。接触抵抗: 100mΩ以下。	○	-
14	繰り返し動作	500回の抜き挿しを実施。 耐電圧: 絶縁破壊の無いこと。 割れ等の異常の無いこと。接触抵抗: 100mΩ以下。	○	-
15	塩水噴霧	塩水濃度: 5% 温度: 35°C 試験時間: 48H 試験後、甚だしい腐食の無いこと。接触抵抗: 100mΩ以下。	○	-
16	二酸化硫黄ガス (SO <sub>2</sub> )	ガス濃度 SO <sub>2</sub> : 10ppm, 温度: 40°C, 試験時間: 96H 試験後、接触抵抗: 100mΩ以下。	○	-
17	はんだ付け性	⚠️ リフロー槽法: ピーク温度 260°C +5/0°C, 10秒 加熱 220°C, 30秒 ~ 60秒、 予備加熱 160°C ~ 180°C, 60秒 ~ 120秒 リフロー回数 2回以下 はんだコテ法: 350°C以下(コテ先), 5秒以内とし、 コンタクトに負荷を与えないこと。 上記条件時、はんだ付け表面がはんだで濡れていること。	○	-
18	はんだ耐熱性	⚠️ リフロー槽法: ピーク温度 260°C +5/0°C, 10秒 加熱 220°C以上の時間60秒 はんだコテ法: 370°C±5°C(コテ先), 4秒 ~ 5秒 上記条件時、外観上熱的損傷、端子のゆるみが無いこと。	○	-

備考 リフロープロファイルについては別紙を参照願います。

2	151130	渡邊	梱包試験追加	加藤	承認		検	-	検		作	
1	150831	渡邊	ピーク温度変更	加藤								
△	年月日	変更者	変更内容	承認	<b>HTK</b> 本多通信工業株式会社				作成: 2015年2月26日			



リフロー温度プロファイル



範囲	温度	時間
Pre-Heating Zone	160°C ~ 180°C	90sec.±30sec.
Soldering Zone	220°C以上	40sec.±20sec.
Peak Temp.	260°C +5 / 0°C	10sec.以内



リフロー回数 : 2 回以下

●ご注意

本記載の温度プロファイルは参考値です。リフロー装置、はんだペースト、基板サイズにより条件が異なりますので、事前に実装確認等の評価をお願い致します。